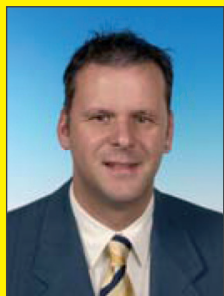


MINEL AG



Minel AG
Kantonsstrasse 57
Postfach 65
8863 Buttikon
Tel. 055 464 35 20
Fax 055 464 35 21
www.minel.ch
info@minel.ch

GESCHÄFTSLEITUNG:

Jack Schlappi

FIRMENGRÜNDUNG:

1971

ANZAHL MITARBEITER:

15

TÄTIGKEIT:

Entwicklung und Fertigung
von Industrie-Elektronik

EMS DIENSTLEISTUNGEN:

- Entwicklung / Layouterstellung
- Materialbeschaffung
- Leiterplattenbestückung THD
- Leiterplattenbestückung SMD
- Kabelkonfektionierung
- Baugruppen /
Geräte-Endmontage
- Funktionsprüfungen
- Vergiessen von
Baugruppen
- Geräterwartungen /
Reparaturen

MITGLIED:

swissT.net
swiss technology network
Electronic Manufacturing

Ziel:

Das Ziel der MINEL AG ist, dem Kunden mit qualitativ hochwertigen Komplettlösungen aus einer Hand, einen optimalen Nutzen zu gewährleisten.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite: www.minel.ch

MINEL AG – IHRE FLEXIBLE EMS OUTSOURCING PARTNERIN

Die MINEL AG ist eine innovative, kosten- und qualitätsbewusste Partnerin für komplette Elektronikdienstleistungen aus einer Hand (EMS = Electronic Manufacturing Services). Sie verfügt über eine langjährige Erfahrung, kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und über eine moderne, rationelle, erstklassige Infrastruktur. Dank ihrer ausgezeichneten Flexibilität kann sie auf individuelle Kundenbedürfnisse eingehen und fertigt Prototypen, kleine und mittlere Serien in bewährter Schweizer Industriequalität.

Fertigungskapazitäten

Neben der THD oder konventionellen Bestückung ist die MINEL AG bereits seit 1986 in der automatisierten SMD-Bestückung tätig. Der SMD-Maschinenpark der MINEL AG wurde kontinuierlich modernisiert, erweitert und den Markt- und Technologie-Anforderungen angepasst. Ein neuer Bestückungsautomat mit einem sehr präzisen Bauteilfördersystem, das sogenannte "Active Feeder System", ist seit Mai 2006 im Einsatz. Dieses System ermöglicht es, immer feinere Strukturen, sprich kleinere Bauteile, verarbeiten zu können. Serienmässig werden heute SMD-Bauteile ab Gehäusegrösse 0402 verarbeitet. Gesamthaft werden jährlich ca. 10 Millionen SMD-Bauteile auf 4 Bestückungsautomaten verarbeitet.



RoHS

- Zur Erhöhung der Lötstellenqualität und Erfüllung der RoHS-Anforderungen werden sämtliche SMD-Baugruppen nur noch mittels dem Dampf-Kondensationsverfahren gelötet. Die dazu benötigte Dampfphasenanlage ist seit März 2006 erfolgreich im Einsatz. Das Dampfphasenlöten (Vapour Phase) eignet sich besonders für den RoHS-konformen Fertigungsprozess und bietet diverse Vorteile wie:
- Sauerstofffreie Lötumgebung => oxidationsfrei => hohe Qualität der Lötstellen
 - sehr genauer Temperaturbereich (bestimmt durch Siedetemperatur des Mediums)
=> keine Überhitzung der Bauelemente
 - gleichmässige Erwärmung der Bauelemente unabhängig von ihrer Masse
 - Stillstand der Baugruppen während des Lötens
 - sehr gute Wärmeübertragungskoeffizienz

